

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2020-046

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于 2019 年度权益分派实施后调整 2020 年度非公开发行 A 股股票发行数量的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的发行数量由不超过 68,903,836 股(含)调整为不超过 96,465,371 股(含)。

### 一、公司 2019 年度权益分派方案及实施情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度权益分派方案已经 2020 年 4 月 24 日的 2019 年年度股东大会审议通过。公司 2019 年年度权益分派方案为：以方案实施前的公司总股本 229,679,455 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税），每股派送红股 0.2 股，以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，共计派发现金红利 22,967,945.5 元，派送红股 45,935,891 股，转增 45,935,891 股，本次分配后总股本为 321,551,237 股。2020 年 5 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《苏州晶方半导体科技股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2020-034），本次权益分派股权登记日为：2020 年 5 月 18 日，除权除息日为：2020 年 5 月 19 日。

截至本公告日，公司 2019 年年度权益分派已实施完毕。

## 二、公司 2020 年度非公开发行 A 股股票发行数量的调整

2019 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了关于非公开发行股票方案等相关议案。2020 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了关于调整非公开发行股票方案等相关议案。2020 年 3 月 27 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整非公开发行股票方案等相关议案。同意本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 68,903,836 股（含）。

### 1、调整前

本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 68,903,836 股（含）。

### 2、调整方式

最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

### 3、调整后

本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 96,465,371 股（含）。

除上述调整外，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 14 日